

中国国际金融股份有限公司
关于
苏州维嘉科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二二年九月

中国国际金融股份有限公司
关于苏州维嘉科技科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

深圳证券交易所：

苏州维嘉科技股份有限公司（以下简称“维嘉科技”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。）

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人名称：	苏州维嘉科技股份有限公司
英文名称：	Suzhou Vega Technology Co., Ltd
注册资本：	3,621.4285 万元
法定代表人：	邱四军
维嘉有限成立日期：	2007 年 4 月 18 日
整体变更设立日期：	2021 年 1 月 7 日
公司住所：	苏州工业园区创苑路 188 号
邮政编码：	215000
电话号码：	0512-62960008
传真号码：	0512-62960052
互联网网址：	www.vegagroup.cn
电子信箱：	investor@vegagroup.cn
信息披露和投资者关系负责部门：	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责部门负责人：	李奕奕
电话号码：	0512-62881008

（二）发行人主营业务

自 2007 年成立以来，维嘉科技一直专注于从事 PCB 核心设备—钻孔及成型专用设备，以及其他专用设备的研发、生产和销售，目前已成长为中国 PCB 核心设备领域的领先企业之一。报告期内，公司的核心产品为 PCB 钻孔设备及 PCB 成型设备，覆盖 PCB 生产的核心工序，产品销量位居行业前列，能够持续满足国内外主要客户对于“高性能、

高品质、低成本”的追求，并提供及时高效的专业服务。PCB 专用设备是 PCB 行业的基础机器设备，涉及多个领域的跨学科综合技术，最终服务于 5G 通信、智能终端、集成电路、汽车电子、云计算、医疗电子及航空航天等国民经济及科技重要领域，亦属于国家当前重点支持的领域，有助于增强电子信息产业链自主可控能力。

维嘉科技以“追求技术创新和领先”为发展理念，长年深耕于 PCB 核心设备—钻孔及成型专用设备的研发创新，在高精度装备控制、高速高精运动控制、电气工程、机器视觉等方面拥有较为深厚的技术积累。截至本上市保荐书出具之日，公司是国内少数拥有 X/Y/Z 多轴独立分体结构成熟技术与三轴全直线驱动技术并实现量产的 PCB 专用设备制造商，可实现超高精度钻孔及成型加工；公司的 Multi 系列钻孔机能够独立补偿各轴定位精度，具备高精度、高效率、高稳定性的产品优势，处于国际先进水平；公司的 Multi 系列铣边机采用三轴全直线驱动技术、视觉补偿技术及深度控制技术，具备高精度成型、控深成型等功能，处于国际先进水平。截至**本上市保荐书出具之日**，公司拥有授权发明专利 109 项、实用新型专利 141 项、软件著作权 46 项。公司曾荣获江苏省科学技术奖三等奖、苏州市科技进步二等奖，并被中国电子电路行业协会及中国电子信息行业联合会评选为“中国电子电路行业百强企业（专用设备与仪器板块）”（2019 年、**2020 年、2021 年**）。此外，公司的多款产品获得江苏省高新技术产品认定，核心产品钻孔机被评为江苏省首台（套）重大装备产品及江苏省专精特新产品。2022 年 8 月，公司入围第四批国家级专精特新“小巨人”企业。

维嘉科技秉承“专业、专注、执着，钻研、创新、协作”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，致力于促进核心技术与实际应用的深度融合。公司产品广泛覆盖硬板、IC 载板、挠性板、刚挠结合板及 HDI 板等众多 PCB 产品类型，获得国内外主要 PCB 制造商的广泛认可。此外，公司实现对下游客户的深度赋能，协助推动下游客户生产工艺的转型升级。报告期内，公司客户涵盖 TTM 集团（TTMI.O）、沪电股份（002463.SZ）、江西红板、景旺电子（603228.SH）、五株集团、嘉立创科技、兴森科技（002436.SZ）、博敏电子（603936.SH）、奥士康（002913.SZ）、崇达技术（002815.SZ）、四会富仕（300852.SZ）、广合科技、高德集团、中富电路（300814.SZ）、相互电子等诸多知名 PCB 制造商。

（三）发行人核心技术与研发水平

公司深耕 PCB 专用设备领域十余年，已经通过自主研发形成了包括 PCB 钻孔与成

型装备控制技术、深度控制技术、基于多传感器融合的产线智能监控技术、多轴运动控制系统及上位软件、基于机器视觉的精密测量及精度补偿技术在内的多项核心技术。其中，公司在 PCB 钻孔装备控制技术、深度控制技术、多轴运动控制技术等关键技术领域已达到国际先进水平，助力我国 PCB 专用设备行业的国产化、高端化进程。

1、主要核心技术及技术来源

技术分类	技术名称	技术来源	成熟程度
PCB 钻孔与成型装备控制技术	结构仿真及优化设计技术	自主研发	已应用于产品量产
	超大推力水冷直线电机技术	自主研发及专利收购	已应用于产品量产
深度控制技术	高精度多参考层探测技术	自主研发	已应用于产品量产
	多轴高精度控深补偿技术	自主研发	已应用于产品量产
	加工数据可追溯技术	自主研发	已应用于产品量产
基于多传感器融合的产线智能监控技术	多传感器融合数据采集系统	自主研发	已应用于产品量产
	分布式数控系统	自主研发	已应用于产品量产
	故障诊断分析系统	自主研发	已应用于产品量产
多轴运动控制系统及上位软件	高速高精度运动控制技术	自主研发	已应用于产品量产
	数据处理及设备驱动软件	自主研发	已应用于产品量产
	工艺参数优化设计技术	自主研发	已应用于产品量产
基于机器视觉的精密测量及精度补偿技术	图像识别算法	自主研发	已应用于产品量产
	视觉系统误差校准算法	自主研发	已应用于产品量产
	空间精度补偿技术	自主研发	已应用于产品量产

2、技术先进性及具体表征

(1) PCB 钻孔与成型装备控制技术

PCB 钻孔与成型装备控制技术用于在复杂工况下连续执行高精度加工。具体而言，钻孔机需要在高速运动状态下（600 孔/分钟）进行 0.1mm 左右直径的微孔高精度加工，任何细微的偏差或者振动都会对钻孔的精度产生不利影响，进而影响 PCB 板的品质。为满足微孔加工的高精度、高效率需求，PCB 钻孔设备需要实现高速、高精度的运动控制。

在 PCB 钻孔与成型装备控制技术领域，公司掌握了结构仿真及优化设计技术、超大推力水冷直线电机技术等多项核心技术，可使钻孔机在超过 350kg 的运动负载下，达

到 90m/min 的最大速度，定位精度可达到 $\pm \leq 0.004\text{mm}$ 。

技术名称	主要内容
结构仿真及优化设计技术	大尺寸多层 PCB 电路板钻孔加工时，钻孔机通常处于高速度、加速度、大载荷和大位移等工况，摩擦、振动、冲击和变形等因素会直接影响机床的动态性能，从而影响设备的精度与运行稳定性。公司通过结构静力学、动力学及运动学仿真分析开发了大尺寸复合材料轻质工作台面，具有重量轻、刚性高、热稳定性能好等特点；通过结构模态分析和优化设计，提升了关键结构固有频率；通过优化钻孔周期运动曲线，提高了钻孔加工效率和精度
超大推力水冷直线电机技术	公司设计开发了超大推力水冷直线电机，具有推力密度高、峰值推力大等特点。采用专利技术设计，降低推力波动，提高控制精度；通过使用多级冷却水路、温度监测与隔热设计，降低设备发热对钻孔精度的影响；Z 轴采用特殊设计的圆筒式直线电机，实现了驱动部和负载质心同轴，从而达到提升精度及效率的效果

（2）深度控制技术

深度控制技术主要用于高端多层电路板盲钻、背钻及控深成型等工艺。随着 PCB 板层数、厚度的不断增加以及结构、生产工艺的日益复杂，下游 PCB 厂商对深度控制加工的需求不断增加且要求越发严格，如 5G 通讯背板因其板厚、铜厚导致层压后内部层间高度均匀性差，给后续盲钻、背钻等工艺带来了极大挑战，因此目前深度控制技术已成为了高端多层板钻孔、成型工艺中的一个重要难点。

公司拥有完善的深度控制技术体系，除传统的基于表面参考层的钻铣深度控制、残厚控制、Mapping 等技术以外，还掌握高精度多参考层探测技术、多轴高精度控深补偿技术、加工数据可追溯技术等多项核心技术，并已应用于 Multi 系列铣边机产品，开发了该系列产品控深成型的独特功能。

技术名称	主要内容
高精度多参考层探测技术	公司开发了高精度多参考层探测技术，通过利用 CBD 电路模块采集在钻孔过程中产生的多脉冲序列信号，结合硬件滤波及软件数据修正，获得精确的多层高度数据。此数据可用于后期精确深度控制加工
多轴高精度控深补偿技术	针对不同的钻孔、成型工艺要求，公司开发有多种深度补偿方法，包括百分比控深补偿、深孔多分段线性补偿、多轴独立深度补偿等，提升了深度控制加工能力
加工数据可追溯技术	通过自主开发的数据记录分析软件，对深度控制加工过程中产生的各类关键数据进行记录、统计、分析及反馈，达到品质管控和产品长期追溯的目的

（3）基于多传感器融合的产线智能监控技术

PCB 钻孔、成型加工是 PCB 制程中的关键工艺环节，决定了 PCB 生产的产能与制程能力，且设备需要 24 小时不间断运行，对设备的稳定性、稼动率要求极为严格，因此需对设备的工作状态进行实时监控。目前机器设备的数据化、智能化水平已成为实现制造业转型升级的重要技术驱动力之一。

公司基于多传感器融合技术开发了全面的智能监控技术体系，拥有包括多传感器融合数据采集系统、分布式数控系统、故障诊断分析系统在内的多项核心技术。

技术名称	主要内容
多传感器融合数据采集系统	通过数据采集系统，上位软件以及布置在设备中的各类温湿度、压力、流量、振动、耗电量传感器对设备运行中的关键数据进行采集，从而实现设备内、外部运行状态的实时监控
分布式数控系统	公司自主开发的 DNC 系统可通过有线或无线网络连接方式对工厂内大量设备进行集中管理和数据收集，该系统包括设备生产信息统计、各轴工作状态监测、加工参数自动导入、稼动率及报警信息统计等功能，从而有效提升了生产管理的及时性，减少了浪费，降低了成本
故障诊断分析系统	通过批量整合设备运行记录文件，收集设备长期生产运行中的数据，并运用软件进行统计分析 & 故障分类，为设备维修、维护保养提供数据参考，从而提高设备长期的稳定性，减少设备维修维护成本

（4）多轴运动控制系统及上位软件

多轴运动控制系统包括高精度直线电机运动平台及下位控制软件，同时可灵活适配多种硬件驱控平台，以及可搭载多种视觉系统，可满足多种高精度加工、检测等场景的需要。

公司开发了多轴运动控制系统及上位软件，掌握了高速高精度运动控制技术、数据处理及设备驱动软件、工艺参数优化设计技术等多项核心技术。

技术名称	主要内容
高速高精度运动控制技术	采用上下位机运动控制架构策略，利用 PC 的上位软件对加工、检测路径作优化预处理，同时下位控制系统基于速度、加速度前馈参数设定和基于速度前瞻扫描的缓冲区运动指令混合算法，作实时运动控制，大大提高了运动速度；通过位置环比例-积分参数设定、单轴分段线性补偿及双线性插补或曲面插补位置点补偿算法，达成高精度运动定位
数据处理及设备驱动软件	通过解析 PCB 行业所使用的多种文件格式，可直接将图纸数据转换为加工或检测数据，并执行加工及检测路径优化，从而节约编程时间并提升生产效率；基于运动指令解析引擎，驱动设备高速、高精度运行
工艺参数优化设计技术	通过设定基于经验参数数据库的多种加工、检测模式，实现对各种工艺应用场景需求的快速匹配，提高加工、检测效率

（5）基于机器视觉的精密测量及精度补偿技术

基于机器视觉的精密测量及精度补偿技术主要用于对工件进行高精度测量、加工精度补偿以及对设备进行空间精度补偿。

公司掌握了图像识别算法、视觉系统误差校准算法、空间精度补偿技术等多项核心技术，除用于 Hole AOI 光学检测设备，也广泛应用于 Multi 系列 PCB 钻铣设备、激光钻孔切割机等设备中，以实现设备精度、工件定位及形变误差的补偿，从而满足高精度加工的要求。

公司正在加速布局更多前沿关键技术的研发，不断加强在研发层面的资源投入，持续追求设备向精度更高、效率更快、性能更稳定的方向发展，为公司打造更加牢固的核心竞争力壁垒。截至本上市保荐书出具之日，公司正在进行的研发项目包括基于机器视觉的 PCBA 智能分板技术的研究项目、高速高精度激光微加工工艺及设备研究、应用于智慧工厂需求的智能化全自动数控钻孔产线等。

技术名称	主要内容
图像识别算法	通过优化算法实现 10 秒内百万级别微小特征的检测，可应用于视觉定位、尺寸测量等方面，有效提升基板的检测效率；通过基于几何特征匹配的亚像素图像特征识别算法，实现了高精度位置、尺寸测量
视觉系统误差校准算法	通过多段拼接校准方式实现超大尺寸相机的精度校准，可对各类视觉成像畸变造成的精度误差进行补偿；通过对 Z 轴分层数据处理方式，对镜头放大倍率误差进行补偿
空间精度补偿技术	运用高精度光学玻璃标定板，对平台进行非线性二维精度补偿，以满足高精度二维加工及检测需要；通过采集、处理运动平台平面度数据，对视觉系统聚焦平面进行空间补偿

（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司合并财务报表主要财务数据及财务指标（经审计）如下：

项目	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	88,902.04	68,296.67	33,482.60
归属于母公司所有者权益（万元）	37,520.98	28,083.24	5,461.20
资产负债率（母公司）	57.86%	58.96%	83.79%
营业收入（万元）	79,772.56	48,124.15	22,968.56
净利润（万元）	9,327.79	5,553.31	1,563.61
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,327.79	5,553.31	1,563.61

项目		2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）		9,113.42	5,542.82	1,704.19
基本每股收益（元）		2.60	1.84	-
稀释每股收益（元）		2.60	1.84	-
加权平均净资产收益率	扣非前	28.44%	62.42%	35.75%
	扣非后	27.78%	62.30%	38.97%
经营活动产生的现金流量净额（万元）		-8,586.28	3,055.95	-3,154.04
现金分红（万元）		0.00	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例		6.25%	3.64%	5.12%

（五）发行人存在的主要风险

1、创新风险

公司所在的 PCB 专用设备行业属于典型的技术密集型行业，涉及多个领域的跨学科综合技术。5G 通信、智能终端、集成电路、汽车电子、云计算及航空航天等应用领域的不断发展推动 PCB 产品性能不断升级，对 PCB 专用设备的要求也随之不断提升。公司需要针对技术及产品进行持续的研发投入以满足客户的高品质及多元化需求。若未来公司的技术创新能力与产品迭代速度无法及时匹配下游客户需求与行业技术发展趋势，或关键前沿技术的研发未能取得相应成果，从而对公司的市场地位产生不利影响。

2、技术风险

（1）现有技术被赶超或替代的风险

报告期内，公司的核心产品覆盖 PCB 关键工序，并面临德国 Schmoll、日本 VIA、中国台湾东台精机、中国台湾大量科技、大族数控等国内外厂商的激烈竞争。随着行业的不断发展，若公司无法保持现有技术的先进性，则存在被竞争对手赶超或被其他先进技术替代的风险，从而对公司的经营业绩和未来发展产生不利影响。

（2）核心技术人才流失的风险

PCB 专用设备行业涉及多个领域的跨学科综合技术，公司的核心技术人员在技术及产品的研发生产过程中发挥至关重要的作用。公司高度重视核心技术团队的建设及稳定性。随着行业竞争日趋激烈，若公司未来不能持续完善具备行业竞争力的薪酬激励机

制、良好的人才培养及储备体系，可能导致核心技术人员的流失，从而对公司的技术创新和产品的研发造成不利影响。

（3）核心技术泄密的风险

经过十余年深耕，公司在 PCB 专用设备行业已形成核心技术能力，为公司在激烈的市场竞争中建立了竞争优势。报告期内，公司的主营业务依赖于核心技术而开展。若公司因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露，将会对公司的生产经营造成不利影响。

3、经营风险

（1）宏观经济及下游行业波动的风险

公司的主营产品主要服务于 PCB 行业，并最终广泛应用于 5G 通信、智能终端、集成电路、汽车电子、云计算及航空航天等终端领域。公司下游行业的景气程度与宏观经济形势密切相关，并受到国家相关产业政策的影响，若未来宏观经济形势或国家相关产业政策发生重大变化，则将影响下游行业的发展环境，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。

（2）市场竞争加剧的风险

随着我国对 PCB 行业的政策支持力度不断提升及我国 PCB 行业技术及服务水平的不断提高，全球 PCB 产能已逐渐向中国大陆转移，进口替代趋势日趋显著，国际竞争日渐激烈。若海外 PCB 设备制造商加大在中国市场的投入或国内专用设备制造商持续布局 PCB 领域，市场竞争将进一步加剧，因此存在导致公司经营业绩下滑的风险。

（3）部分原材料供应依赖境外及单一供应商的风险

报告期内，公司重视原材料来源的多元化，但部分关键器件例如控制系统、主轴及导轨仍分别依赖于境外品牌德国 SIEB&MEYER AG、英国诺万特（NOVANTA）及日本 THK。报告期内各期，公司向上述三家境外品牌采购的合计金额分别为 4,983.17 万元、12,351.83 万元和 23,496.56 万元，占当期采购总额的比例分别为 27.69%、30.84%和 34.82%（公司采购境外品牌的合计金额分别为 6,551.66 万元、15,286.48 万元和 28,832.97 万元，占当期采购总额的比例分别为 36.41%、38.16%和 42.73%）。报告期内，境外供应商 SIEB&MEYER AG 是公司采购控制系统的单一供应商，报告期内采购系统的金额分别

为2,838.63万元、6,152.37万元和13,020.02万元，占当期采购总额的比例分别为15.78%、15.36%和19.30%。

公司与该等境外供应商已建立长期稳定的合作关系（公司与SIEB&MEYER AG的合作始于2007年，与诺万特合作始于2011年，与THK合作始于2014年），并与SIEB&MEYER、THK均签署了战略合作协议。报告期内，公司积极加强与国内品牌供应商在关键器件方面的合作，例如公司向广州市昊志机电股份有限公司采购主轴，以及与控制系统提供商深圳市冰海科技有限公司签订战略合作协议约定合作研发高端PCB数控加工设备控制系统等，但若因国际政治局势恶化，全球贸易摩擦加剧等因素导致境外相关国家进行出口限制，则会对公司的生产经营产生不利影响。

（4）新产品的开拓风险

自成立以来，公司一直专注于PCB核心设备—钻孔及成型专用设备的研发创新。报告期内，公司的主营业务收入大部分来自于核心产品PCB钻孔设备及成型设备，核心产品销量位居行业前列，并已拥有一定的竞争优势，但产品结构仍较为单一。公司正在积极开展新专用设备的研发工作，从而在提高销售规模的同时分散经营风险。为应对新产品领域的市场竞争，公司需投入较多的资源开展技术研发、产品落地以及市场销售等工作。若公司的开发策略、产品性能及服务无法满足下游客户的需求，公司将面临新产品的开拓风险。

（5）发行人中小客户占比较高的风险

报告期内各期，发行人向中小型客户的销售金额占发行人当期销售总额的比例分别为27.93%、40.48%和41.85%，总体呈现上升趋势，主要系国内PCB行业竞争高度分散，且自2020年起的新冠疫情导致全球PCB行业产能加速向中国大陆转移且下游需求旺盛，国内PCB行业涌入以中小型企业规模为主的新厂商。发行人凭借良好的产品性价比及较为专业且及时的服务成功拓展不少中小型客户。发行人部分中小客户的经营规模较小，产品类型相对单一，若未来该等客户无法适应PCB产品高端化发展趋势，或导致经营情况有所恶化，进而导致发行人无法继续与该等客户合作及应收账款回款情况存在不确定性。

（6）产品质量控制的风险

公司的核心产品PCB钻孔设备及成型设备是PCB生产所需的核心设备，产品质量

对下游客户的生产经营至关重要。PCB 专用设备的装配及调试过程较为复杂，若因产品质量把控不严或其他不可控因素导致产品质量未能满足客户的需求，将对公司的市场声誉、经营业绩造成不利影响。

（7）持续经营能力风险

公司的持续经营能力受到行业与技术发展趋势、政策形势、行业壁垒、下游行业需求、市场竞争状况、已有产品优势等多个因素的影响。公司所处 PCB 专用设备行业属于典型的技术密集型行业，公司需要针对技术及产品进行持续的研发投入以满足客户的需求。若公司未来无法适应行业与技术发展趋势，或政策形势、行业壁垒、下游行业、市场竞争或已有产品优势等因素发生不利变化，则将对公司的持续经营能力造成不利影响。

（8）限电政策的风险

公司生产所使用的主要能源为电力，近期国内限制工业用电政策对公司的生产经营造成一定影响。此外，限制工业用电政策亦会影响下游 PCB 厂商的生产经营活动，从而一定程度地影响 PCB 设备的市场需求。截至本上市保荐书出具之日，受益于煤炭价格整体呈下降趋势及保供电措施的出台，限制工业用电政策已有所放松。若未来持续限制工业用电，则将对公司的生产经营造成一定影响。

（9）芯片供应链紧张的风险

近期全球电子芯片供应链紧张对汽车、通讯、消费电子等 PCB 终端应用领域造成一定影响。若芯片供需持续失衡，部分终端应用领域将放缓出货速度，从而影响 PCB 产品的交货周期，进而或对公司的未来经营业绩造成一定影响。

4、内控风险

通过十余年的持续发展，公司已逐步建立了较为完善的内控制度，但随着公司业务规模及员工规模的不断增长，公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的内部控制水平和管理水平提出了更高的要求。若公司的内控制度无法持续完善或管理能力无法持续提高，将可能引发相应的内控风险，进而对公司整体经营产生不利影响。

5、财务风险

(1) 经营业绩波动的风险

报告期内各期，公司营业收入分别为 22,968.56 万元、48,124.15 万元及 79,772.56 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,704.19 万元、5,542.82 万元及 9,113.42 万元，整体呈现较快增长态势。公司的经营业绩与宏观经济环境、产业政策、技术发展、行业竞争、上下游行业发展状况等外部因素及公司经营策略、技术及产品研发、市场开拓、质量控制、服务能力、内部控制等内部因素密切相关，则公司将面临经营业绩波动的风险。

(2) 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司的经营业绩整体呈快速增长趋势。2022 年上半年全国各地多点疫情爆发，上海市及华东地区实施较长时间的疫情管控，发行人的采购、生产、销售及物流活动均受到一定影响。新冠疫情封控措施也导致部分客户产能扩充进度转缓，进而延迟了对发行人产品的验收，导致发行人部分订单交付有所延迟。此外，新冠疫情的持续及全球宏观经济下行导致电子终端产品市场需求较为低迷，进而导致公司下游 PCB 厂商产能扩充速度减缓，对 PCB 设备的采购需求及意愿有所下滑。上述因素可能导致发行人 2022 年经营业绩出现下滑。

(3) 经营业绩无法保持持续快速增长的风险

PCB 行业整体呈现“周期+成长”的特性，行业整体规模及增长情况与下游行业景气程度及终端客户需求高度相关。近年来，得益于 5G 通信网络的成熟、移动互联网的普及、集成电路的发展、大数据的应用及 Mini-LED、AR/VR、可折叠手机、电动汽车等新兴产品和新技术的出现，全球 PCB 市场呈现稳健增长态势。在 PCB 行业快速增长的带动下，报告期内各期，公司营业收入分别为 22,968.56 万元、48,124.15 万元及 79,772.56 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,704.19 万元、5,542.82 万元及 9,113.42 万元，整体呈现较快增长态势。若未来宏观经济下行导致通讯、计算机、汽车电子、消费电子等 PCB 主要下游应用领域需求低迷，进而导致公司下游 PCB 厂商产能扩充速度减缓，发行人下游客户对 PCB 设备需求也将受到影响，发行人可能存在经营业绩无法持续快速增长的风险。

(4) 电子终端产品市场需求低迷的风险

在新冠疫情蔓延及全球地缘政治局势剧烈波动的背景下，2022 年全球宏观经济面临下行压力，通讯、计算机、汽车电子、消费电子等 PCB 主要下游应用领域需求低迷，进而导致公司下游 PCB 厂商产能扩充速度减缓，发行人下游客户对 PCB 设备需求也受到影响。受到行业趋势的影响，下游客户 2022 年 1-6 月营业收入增速有所放缓，发行人 2022 年 1-6 月营业收入出现了负增长。此外，发行人的经营性现金流量也受到行业趋势影响，对发行人的资金周转造成了一定压力。若未来宏观经济形势持续恶化导致电子终端产品市场需求持续低迷，则发行人面临业绩下滑及资金紧张的风险。

(5) 应收账款账面价值较大的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,444.54 万元、17,547.40 万元和 34,932.31 万元，占当期期末流动资产的比例分别为 43.06%、29.05%和 43.81%。随着销售收入的不断增长，公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模较大，从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。若下游客户的财务状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款出现坏账从而影响经营业绩的风险。

(6) 存货余额较大的风险

报告期内各期末，公司存货账面价值分别为 6,641.73 万元、13,606.08 万元和 28,298.17 万元，占当期流动资产的比例分别为 24.99%、22.53%和 35.49%。公司存货主要由发出商品、在产品和原材料组成。报告期内各期末，公司存货余额持续增长，但并未出现大幅跌价的情况。若未来公司对市场需求预测出现重大偏差，市场需求或市场价格出现大幅下降，将导致公司存货可变现净值减少，存货跌价风险提高，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(7) 经营性现金流净额与净利润金额差异较大的风险

报告期内各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,154.04 万元、3,055.95 万元和-8,586.28 万元，净利润分别为 1,563.61 万元、5,553.31 万元及 9,327.79 万元。经营活动现金流量净额低于净利润的主要原因为经营性应收项目增加以及业务规模增加导致的大规模存货备货。截至 2022 年 6 月 30 日，公司截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末应收账款的回款比例分别为 99.81%、85.04%和 43.20%。随着公司经营规模不断扩大，营运资金需求日益增加，公司可能面临经营活动现金流量净额持续低于净利润金额

的情况,从而导致业务运营资金不足,进而对公司的财务状况及生产经营产生不利影响。

(8) 原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括大理石基座、导轨、电机、光栅尺、主轴、控制系统、电子元器件等。报告期内各期,公司的直接材料成本分别为 15,792.41 万元、33,245.45 万元和 54,470.27 万元,占当期主营业务成本的比例分别为 95.37%、95.40%和 94.60%。公司与主要供应商已建立了长期稳定的合作关系,相关原材料市场供应充足且价格相对稳定。因发行人与客户签订的销售合同未约定原材料价格波动的调价机制,若主要供应商的生产经营突发重大不利变化或原材料市场出现大幅提价等状况,则将会对公司的经营业绩造成不利影响。假设其他因素不变,若原材料采购价格降低或上升 1%时,2019 年、2020 年和 2021 年主营业务毛利率分别上升或降低 0.70 个百分点、0.70 个百分点和 0.69 个百分点;若原材料采购价格降低或上升 5%时,2019 年、2020 年和 2021 年主营业务毛利率分别上升或降低 3.52 个百分点、3.51 个百分点和 3.45 个百分点。

(9) 收入季节性波动的风险

2019 年、2020 年和 2021 年,公司第四季度的主营业务收入占当年主营业务收入的占比分别为 29.20%、38.02%、24.84%,第三、四季度合计主营业务收入占比分别为 60.10%、72.91%和 56.57%。PCB 专用设备行业收入确认存在一定的季节性特征,下半年确认收入占比较高,主要原因是下游 PCB 生产企业通常在上半年制定当年的项目扩产投资计划,期间陆续经过采购、安装、调试等流程,于下半年对设备进行验收。主营业务收入季节性波动将增加公司执行生产计划、资金使用等运营难度,进而可能造成一定不利影响。

(10) 公司所得税优惠政策的风险

公司于 2015 年、2018 年、2021 年分别取得高新技术企业证书(证书编号分别为 GR201532002070、GR201832004430、GR202132009205)。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,2019 年至 2021 年公司作为高新技术企业享受企业所得税税率为 15%的税收优惠。若公司相应的税收优惠政策发生变化,公司将无法继续享受上述相关税收优惠,从而将对公司的经营业绩造成不利影响。

(11) 汇率变动及汇兑损益波动的风险

报告期内,受国家推进人民币汇率形成机制市场化改革、扩大人民币汇率弹性及全

球经济形势的影响，人民币汇率波动性较大。公司的境外销售比例较低，但存在一定比例的境外采购，导致公司存在一定数额的汇兑损益。报告期内各期，公司汇兑损益分别为 27.94 万元、136.14 万元和-341.45 万元。若未来人民币对外汇的汇率波动幅度加大，将可能对公司的经营业绩产生不利的影响。

（12）分期收款结算对现金流带来的影响

报告期内各期，公司分期收款结算方式实现的销售收入分别为 8,564.06 万元、20,398.26 万元和 30,931.72 万元，占营业收入比例分别为 37.29%、42.39%和 38.77%，占比整体较高。公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,154.04 万元、3,055.95 万元和-8,586.28 万元，波动较大。发行人所处专用设备制造业的行业特点和结算模式对经营活动现金流有较大影响，在原材料采购环节需进行部分主要原材料全额预付款、适度备货等，在客户结算收款时，发行人根据谈判与市场竞争采取一定比例的分期收款模式，其中分期数较长的款项回款进度与公司支付原材料采购款等的资金支出进度并不完全匹配同步，故分期收款模式导致的回款速度较慢对公司运营资金的占用有所增加，从而对公司资金及现金流带来一定压力。若公司面临因分期收款模式回款速度较慢或无法收回款项的情形，将导致公司运营资金不足及现金流情况较差，对公司生产经营产生不利影响。

6、法律风险

（1）实际控制人邱四军先生与股东之间股权回购条款被执行的风险

1) 丰年君和、木立创投

丰年君和与木立创投入股公司时，曾与维嘉有限、邱四军、常远、何妍、朱劼、维嘉凯悦约定股权回购条款，其在特定情形下享有要求维嘉有限、邱四军履行股权回购义务的权利。丰年君和、木立创投已各自与发行人、邱四军、常远、何妍、朱劼、维嘉凯悦签署了终止协议，同意此前投资协议中的回购及其他特别权利条款效力将全部且不可恢复地终止，并将被视为自始无效。

2021 年 8 月 10 日，丰年君和与邱四军签署《关于维嘉数控科技（苏州）有限公司的投资协议之补充协议二》，约定丰年君和在发生特定事件时有权要求邱四军向其履行股权回购义务，具体触发事件包括发行人未能于 2022 年 3 月 31 日前完成 IPO 申报并获受理、发行人未能于 2023 年 3 月 31 日前实现合格上市。关于该补充协议约定详情请

见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

2021年8月10日，木立创投与邱四军签署《<关于维嘉数控科技（苏州）有限公司之投资协议>之补充协议》，约定木立创投在发生特定事件时有权要求邱四军向其履行股权回购义务，具体触发事件包括发行人未能于2022年3月31日前完成IPO申报、发行人未能于2023年3月31日前实现合格上市。关于该补充协议约定详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

2021年11月，为简化股份回购流程，进一步明确邱四军的回购义务，丰年君和与邱四军签署《关于维嘉数控科技(苏州)有限公司的投资协议之补充协议三》，该补充协议关于回购义务及具体触发事件的约定与《关于维嘉数控科技（苏州）有限公司的投资协议之补充协议二》一致。根据该补充协议约定，该补充协议替代了《关于维嘉数控科技（苏州）有限公司的投资协议之补充协议二》，《关于维嘉数控科技（苏州）有限公司的投资协议之补充协议二》于该补充协议生效之日起终止履行并自始无效。关于该补充协议约定详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

2021年11月，为简化股份回购流程，进一步明确邱四军的回购义务，木立创投与邱四军签署《<关于维嘉数控科技(苏州)有限公司之投资协议>之补充协议二》，该补充协议关于回购义务及具体触发事件的约定与《<关于维嘉数控科技（苏州）有限公司之投资协议>之补充协议》一致。根据该补充协议约定，该补充协议替代了《<关于维嘉数控科技（苏州）有限公司之投资协议>之补充协议》，《<关于维嘉数控科技（苏州）有限公司之投资协议>之补充协议》于该补充协议生效之日起终止履行并自始无效。关于该补充协议约定详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

2）安徽安元、中金浦成、顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金

安徽安元、中金浦成入股公司时，曾与维嘉有限、邱四军、常远、何妍、朱劼、维

嘉凯悦、木立创投及丰年君和约定股权回购条款，其享有要求维嘉有限、邱四军履行股权回购义务的权利。安徽安元、中金浦成已各自与发行人、邱四军、常远、何妍、朱劼、维嘉凯悦、木立创投及丰年君和签署终止协议，同意股权回购及其他特别权利条款的法律效力全部且不可恢复地终止，并将被视为自始无效。

顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金入股时，曾与维嘉有限、邱四军、常远、何妍、朱劼、维嘉凯悦、木立创投及丰年君和约定股权回购条款，其享有要求邱四军履行股权回购义务的权利。顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金已各自与发行人、邱四军、常远、何妍、朱劼、维嘉凯悦、木立创投及丰年君和签署终止协议，同意股权回购及其他特别权利条款的法律效力全部且不可恢复地终止，并将被视为自始无效。

2021年8月10日，安徽安元、中金浦成、顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金与邱四军另行签署《<维嘉数控科技（苏州）有限公司增资补充协议>之补充协议》，约定安徽安元、中金浦成、顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金在发生特定事件时有权要求邱四军向其履行回购义务，具体触发事件包括发行人未能于2022年3月31日前就发行人合格发行上市向中国证监会或证券交易所提交申报材料且被中国证监会或证券交易所正式受理、发行人未能于2023年3月31日前完成合格发行上市。关于该补充协议约定详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

2021年11月，为简化股份回购流程，进一步明确邱四军的回购义务，安徽安元、中金浦成、顺融开拓二号及顺融天使四期、海富长江及中比基金与邱四军另行签署《<维嘉数控科技(苏州)有限公司增资补充协议>之补充协议二》，该补充协议关于回购义务及具体触发事件的约定与《<维嘉数控科技（苏州）有限公司增资补充协议>之补充协议》一致。根据该补充协议约定，该补充协议替代了《<维嘉数控科技（苏州）有限公司增资补充协议>之补充协议》，《<维嘉数控科技（苏州）有限公司增资补充协议>之补充协议》于该补充协议生效之日起终止履行并自始无效。关于该补充协议约定详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本有关情况”之“（八）发行人签订的对赌协议及解除情况”之“3、实际控制人签订的对赌协议条款及安排”。

若补充协议项下约定的相关情形发生，将可能导致触发实际控制人邱四军的回购义

务，因此存在导致发行人现有股东持股比例发生变化的风险。

(2) 核心知识产权被侵权的风险

公司坚持独立自主创新，主营业务产品的核心技术主要通过自主研发完成。截至**本上市保荐书出具之日**，公司拥有授权发明专利**109**项、实用新型专利**141**项、软件著作权**46**项。近年来，我国科技创新环境持续改善，知识产权保护力度不断提升，但仍然存在针对专利和技术的侵权行为。若未来公司的研发成果或核心技术等知识产权受到侵犯，且公司未能采取及时有效的保护措施，将对公司造成不利影响。

(3) 社会保险和住房公积金缴纳不规范的风险

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情况。报告期内公司虽未因社保及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政处罚，但公司仍存在未来被要求补缴社保及住房公积金的可能，进而影响公司经营业绩，并可能被主管机关追责。

7、本次发行失败的风险

按照《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，本次发行应当中止。若公司中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将会出现发行失败的风险。因此，本次发行在一定程度上存在发行失败的风险。

8、与募集资金运用相关的风险

(1) 募投项目建设用地手续尚未完成的风险

经公司第一届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会以及第一届董事会第八次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟以招拍挂形式取得“高速高精PCB钻铣及检测设备生产基地建设项目”的建设用地。

高速高精PCB钻铣及检测设备生产基地建设项目选址于江苏省常熟市黄山路以东，珠泾路以北空地。截至本上市保荐书出具之日，公司已与常熟高新技术产业开发区委员会签署了《项目协议书》以及《<项目协议书>补充协议》，常熟市产业项目用地评价领导小组办公室亦印发了《产业项目评价意见书》，但取得本次募投项目建设用地相关产

权证前尚需完成建设用地方案报审、缴纳土地出让金、签订《土地使用权出让合同》等程序。若公司无法按照计划完成募投项目用地的出让手续取得土地，将会对募集资金投资项目的正常开展产生不利影响。

(2) 募集资金投资项目的实施风险

本次募集资金投资项目金额较大，实施周期及投资回收期较长。虽然公司已对募集资金投资项目的可行性进行谨慎论证，但募集资金投资项目的可行性研究是基于当前市场环境及行业发展趋势等因素所作出的，项目实际实施效果与未来行业发展情况、市场供求状况、技术发展趋势、竞争格局及原材料价格等外部因素密切相关。若未来前述外部因素在项目实施过程中发生重大不利变化，导致募集资金投资项目未能按照计划顺利实施或募投项目效益不达预期，则公司将面临无法按计划实施募投项目或无法实现预期收益的风险。

(3) 募投项目新增折旧摊销带来的业绩风险

本次募投资金投资项目规模较大，募投项目实施后固定资产规模将大幅增加，而项目产生收益需要一定时间，因此在短期内募投项目新增折旧和摊销或将对公司经营业绩产生一定的影响。根据公司现行折旧及摊销政策，募投项目新增的固定资产及无形资产所产生的折旧、摊销金额自第四年起年均约 2,892.45 万元。若项目建成后市场环境等因素发生重大不利变化，导致本次募投项目所带来的综合效益提升无法抵消上述新增的折旧摊销费用，则将会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

(4) 短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

本次发行完成后，随着募集资金到位，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增长，而募集资金投资项目的实施及达产需要一定时间，在项目全部建设完成并达产后才能逐步实现预期收益。因此，公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

9、其他相关的风险

(1) 新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险

2020 年初，国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，为及时阻断疫情，国内实施了一系列严格的防疫管控措施。目前新冠疫情在中国已得到较好的控制，但若国内疫情出现反

复，以及国外疫情的持续或对公司及上下游产业链的企业带来较大影响，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

（2）不可抗力的风险

火灾、暴雨、洪水、地震等自然灾害及突发性公共卫生事件等不可抗力因素会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营，从而或对公司的经营业绩产生不利影响。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行规模	本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过 1,207.1429 万股（不考虑超额配售选择权），不低于发行后总股本的 25%（全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份）
发行人高管、员工拟参与配售情况	公司高级管理人员、核心员工等拟参与本次发行的战略配售，具体按照深交所相关规定执行，后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构及其相关子公司后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案
发行方式	采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

郭佳华：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾担任深交所主板上市公司石化机械非公开发行股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吴磊磊：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：熊延深，于 2019 年取得证券从业资格，曾经执行万达电影非公开发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他人员情况

其他项目组成员：潘念欧、谢雨萌、王子路、谭珺。

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）截至本上市保荐书出具之日，中金浦成为持有发行人 2.2485%股份的股东，其为发行人本次发行的保荐人（主承销商）中金公司的全资子公司。中金浦成以自有资金认购发行人股份事宜不存在违反《证监会机构监管部关于证券公司直接投资业务监管指引》关于直投业务规定的情形。除前述情形外，不存在其他保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）截至本上市保荐书出具之日，不存在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）截至本上市保荐书出具之日，不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至 2021 年 12 月 31 日，中央汇金直接持有中金公司约 40.11%的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司共持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显

示,截至本上市保荐书出具之日,不存在中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间相互持股的情况,不存在中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间相互提供担保或融资的情况。

(五)截至本上市保荐书出具之日,保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

(一) 本机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序,同意推荐发行人证券发行上市,并据此出具本上市保荐书。

(二) 作为苏州维嘉科技科技股份有限公司本次发行的保荐机构,本机构:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

6、保证本上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范;

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

9、自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

六、保荐机构对本次发行的推荐结论

本机构作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后，认为发行人具备首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件。因此，本机构同意保荐维嘉科技首次公开发行股票并在创业板上市。

七、本次发行履行了必要的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了必要的决策程序，具体如下：

（一）董事会决策程序

2021年9月1日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案》《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》《关于制定<苏州维嘉科技股份有限公司章程（上市草案）>的议案》《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施和相关承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案，对本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议。

（二）股东大会决策程序

2021年9月16日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，对发行人第一届董事会第七次会议审议并提交的与本次发行有关的议案进行审议，包括：《关于公司首次

公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案》《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》《关于制定<苏州维嘉科技股份有限公司章程（上市草案）>的议案》《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施和相关承诺的议案》等与本次发行上市有关的议案。上述议案经出席本次股东大会的股东以所持表决权的 100%通过。

综上，保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了必要的决策程序。

八、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的逐项说明

（一）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件”规定

（1）经核查，发行人系由维嘉数控科技（苏州）有限公司（下称“维嘉有限”）以经审计确认的账面净资产折股整体变更设立并合法有效存续的股份有限公司，其持续经营时间自维嘉有限 2007 年 4 月 18 日成立至今已超过三年，同时，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条之规定。

（2）经核查，并根据《审计报告》、《内部控制鉴证报告》及发行人确认，保荐机构认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的《内部控制鉴证报告》，符合《注册管理办法》第十一条之规定。

（3）经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

1) 发行人资产完整, 业务及人员、财务、机构独立, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争, 以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易, 符合《注册管理办法》第十二条第(一)项之规定。

2) 发行人最近两年内主营业务未发生重大变化, 发行人最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化, 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份权属清晰, 最近两年实际控制人没有发生变更, 不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷, 符合《注册管理办法》第十二条第(二)项之规定。

3) 发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷, 重大偿债风险, 重大担保、诉讼、仲裁等或有事项, 经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项, 符合《注册管理办法》第十二条第(三)项之规定。

综上, 保荐机构认为: 发行人符合《注册管理办法》第十二条之规定。

(4) 经核查:

1) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定, 符合国家产业政策, 符合《注册管理办法》第十三条第一款之规定。

2) 最近三年内, 发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪, 不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为, 符合《注册管理办法》第十三条第二款之规定。

3) 发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚, 或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见等情形, 符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

(二) 发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“(二) 发行后股本总额不低于 3000 万元”规定

经核查, 发行人本次发行前股本总额为 3,621.4285 万元, 本次拟发行股份不超过 1,207.1429 万股(不考虑超额配售选择权), 发行后股本总额不超过人民币 4,828.5714 万元, 符合上述规定。

（三）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次拟发行股份不超过 1,207.1429 万股（不考虑超额配售选择权），发行后公司股本总额不超过人民币 4,828.5714 万元，公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，符合上述规定。

（四）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

1、标准适用判定

发行人结合自身状况，选择适用《上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。

2、财务指标

发行人 2020 年、2021 年归属于母公司所有者的净利润(扣非后孰低)分别为 5,542.82 万元、9,113.42 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此符合所选上市标准。

（五）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上，本保荐机构认为，发行人已经具备本次发行上市的实质条件。

九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

本保荐机构在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度对发行人进行持续督导。

事 项	安 排
（一）持续督导事项	在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

事 项	安 排
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理办法》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、督导发行人严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保公司高管人员尽力协助保荐机构进行持续督导； 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于苏州维嘉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》之签署页）

董事长、法定代表人：


沈如军

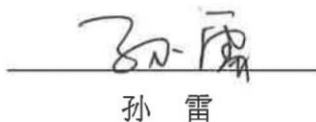
2022年 9 月 2 日

首席执行官：


黄朝晖

2022年 9 月 2 日

保荐业务负责人：


孙 雷

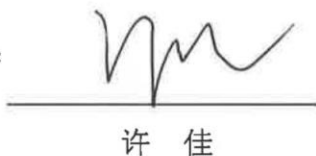
2022年 9 月 2 日

内核负责人：


杜祎清

2022年 9 月 2 日

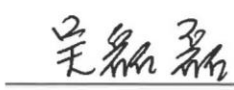
保荐业务部门负责人：


许 佳

2022年 9 月 2 日

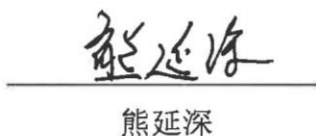
保荐代表人：


郭佳华


吴磊磊

2022年 9 月 2 日

项目协办人：


熊延深

2022年 9 月 2 日

保荐机构公章

中国国际金融股份有限公司



2022年 9 月 2 日